



中华人民共和国国家标准

GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2005
代替 GB/T 16467—1996

电子设备用固定电容器 第 19-1 部分：空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜 介质直流固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 19-1: Blank detail specification—
Fixed metallized polyethylene-terephthalate film
dielectric surface mount d.c. capacitors—
Assessment level EZ

(IEC 60384-19-1:2005, IDT)

2013-12-31 发布

2014-08-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2007)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-3-1:2007)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体(MnO₂)电解质的铝电解固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-4-2:2007)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2011)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:2005)；
- 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—1998/IEC 60384-14-1:2005)；
- 第 15 部分：分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982,第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992)；

- 第 15-1 部分:空白详细规范 固体电解质钽箔固定电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1984);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 表面安装固体和非固体电解质铝电解固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2006);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2005);
- 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 19-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 16467—1996《电子设备用固定电容器 第 19 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器 评定水平 E》。本部分与 GB/T 16467—1996 相比,主要变化如下:

- 增加了引用文件 IEC 60410;
- 评定水平 E 变更为评定水平 EZ;
- 质量一致性检验中 A2 分组调整为 A0 分组,由 IL=II、AQL=1.0%调整为 100%检验;B、C 分组的合格判定数由 1 变更为 0;
- 表 4 中 4.6.2 持续时间:“5 s±0.5 s”删除。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-19-1:2005《电子设备用固定电容器 第 19-1 部分:空白详

细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 15448—2013 电子设备用固定电容器：第 19 部分：分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-19:2006, IDT)；

——GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第 1 部分：总规范(idt IEC 60384-1:1999)。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位：河南华中星科技电子有限公司。

本部分主要起草人：李素兰、樊金河、孟素芬、谷斌、林晋涛、宁小波。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16467—1996。

电子设备用固定电容器
第 19-1 部分:空白详细规范
表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜
介质直流固定电容器 评定水平 EZ

引言

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,并包括详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范不能认为是符合 IEC 要求的规范,也不能称作 IEC 规范。

制订详细规范时应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号内数字标注的位置上填写下列相应内容:

详细规范的识别

- (1) 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- (2) IEC 和国家标准的详细规范编号、出版日期以及国家体制需要的更多内容。
- (3) IEC 和国家标准的总规范编号及其版本号。
- (4) IEC 空白详细规范编号。

电容器的识别:

- (5) 该型号电容器的简述。
 - (6) 典型结构的简述(适用时)。
- 当电容器不是设计用于印制线路板时,详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。
- (7) 对互换性有重要影响的主要尺寸的外形图,和(或)引用国家和国际的外形方面的文件。也可在详细规范的附录中给出这种图形。
 - (8) 应用或应用组别和(或)评定水平。

注:详细规范中采用的评定水平(或几个评定水平)应从分规范中 3.5.4 中选取。这意味着如果试验的分组不变,几个评定水平可以共用一个空白详细规范。

- (9) 重要特性的参考数据,以便在各种类型电容器之间进行比较。